

Searching PAJ

1/2 ページ

## PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 08-330356

(43)Date of publication of application : 13.12.1996

(51)Int.Cl.

H01L 21/60  
H01L 21/3206  
H01L 21/769

(21)Application number : 08-007813

(71)Applicant : SHINKO ELECTRIC IND CO LTD

(22)Date of filing : 19.01.1996

(72)Inventor : AKAGAWA MASATOSHI

(30)Priority

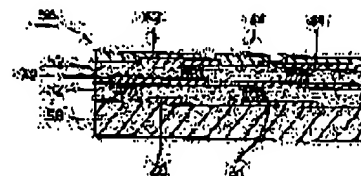
Priority number : 07 65609 Priority date : 24.03.1995 Priority country : JP

## (54) ANISOTROPIC CONDUCTIVE SHEET WITH CONDUCTIVE LAYER AND WIRING BOARD USING THE SHEET

(57)Abstract:

PURPOSE: To provide a thin wiring board, having the upper and the lower wiring patterns which can be electrically connected easily, which can be manufactured easily.

CONSTITUTION: A plurality of anisotropic conductive sheets 52, on which a wiring pattern 62 is formed on one surface, are laminated and fixed, the other surface of the lowest layer of anisotropic conductive sheet 52 is fixed to the other surface of the printed wiring board 58 where a wiring pattern 60 is formed on the surface, the wiring patterns 60 and 62 are electrically connected through the anisotropic conductive sheet 52, and an electric insulating film 64 is formed by exposing the outer connection part of the wiring pattern 62 of the top layer of anisotropic conductive sheet 52.



## LEGAL STATUS

[Date of request for examination] 22.11.2002

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number] 3549316

[Date of registration] 30.04.2004

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's]

<http://www19.ipdl.ncipi.go.jp/PA1/result/detail/main/wAAA2RaaP1DA408330356P1.htm>

2004/11/28

Searching PAJ

2/2 ページ

decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C) 1998,2003 Japan Patent Office

(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開平8-330356

(49) 公開日 平成8年(1996)12月13日

(51) Int. Cl. <sup>5</sup>	識別記号	庁内整理番号	FI	特許表示箇所
H01L 21/80	H11		H01L 21/80	H11R
21/3205			21/88	M
21/708			21/80	B

請求項 未請求 請求項の表 〇 L (全 9 頁)

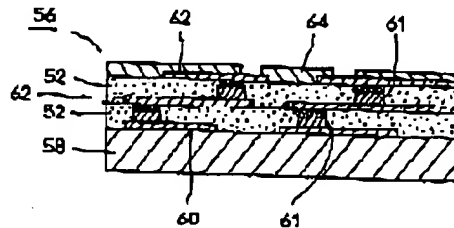
(21) 出願番号	特願平7-7819	(71) 出願人	Onoda Cement Co., Ltd. 新光電機工業株式会社 長野県長野市大字栗田字金和田711番地
(22) 出願日	平成8年(1996)1月19日	(72) 発明者	安川 雅俊 長野県長野市大字栗田字金和田711番地 新光電機工業株式会社内
(31) 優先権主張番号	特願平7-85608	(74) 代理人	弁理士 飯野 隆夫 (外1名)
(32) 優先日	平7(1995)8月24日		
(33) 優先権主張国	日本 (J P)		

(54) [発明の名称] 導体層付異方性導電シートおよびこれを用いた配線基板

(57) [要約]

【課題】 上下の配線パターン間の電気的接続が容易で容易に製造でき、また厚さも薄くできる配線基板を提供する。

【解決手段】 一方の面に配線パターン62が形成された異方性導電シート52が銅箔被覆して固着され、かつ最下層の異方性導電シート52の他方の面で、表面に配線パターン60が形成されたプリント配線基板58面に固着され、前記配線パターン60、62間の前記異方性導電シート52を介して電気的に接続されており、最上層の異方性導電シート52の配線パターン62の外部接続部62aを露出して電気的絶縁皮膜64が形成されていることを特徴としている。



(2)

特開平 8-330356

1

【特許請求の範囲】

【請求項1】 樹脂中に金属粉等の導電フィラーが配合された異方性導電シートと、表面に導体層が形成されていることを特徴とする導体層付異方性導電シート。

【請求項2】 導体層が金属箔である請求項1記載の導体層付異方性導電シート。

【請求項3】 表面に配線パターンが形成された基板面に一方の面に配線パターンが形成された異方性導電シートの他方の面が固着され、該配線パターン間が前記異方性導電シートを介して電気的に接続されており、前記異方性導電シートに形成された配線パターンの外部接続部を露出して電気的絶縁皮膜が形成されていることを特徴とする配線基板。

【請求項4】 前記異方性導電シートに形成された配線パターンにより前記異方性導電シートが押圧されることにより電気的に接続されていることを特徴とする請求項3記載の配線基板。

【請求項5】 前記基板面に形成された配線パターンにバンパが形成され、該バンパにより前記異方性導電シートが押圧されることにより電気的に接続されていることを特徴とする請求項3記載の配線基板。

【請求項6】 一方の面に配線パターンが形成された異方性導電シートが複数枚積層して固着され、かつ最下層の異方性導電シートの他方の面が表面に配線パターンが形成された基板面に固着され、前記配線パターン間が前記異方性導電シートを介して電気的に接続されており、最上層の異方性導電シートに形成された配線パターンの外部接続部を露出して電気的絶縁皮膜が形成されていることを特徴とする配線基板。

【請求項7】 前記異方性導電シートに形成された配線パターンにより前記異方性導電シートが押圧されることにより電気的に接続されていることを特徴とする請求項6記載の配線基板。

【請求項8】 前記基板面に形成された配線パターンおよび内層となる異方性導電シートに形成された配線パターンにバンパが形成され、該バンパにより前記異方性導電シートが押圧されることにより電気的に接続されていることを特徴とする請求項6記載の配線基板。

【請求項9】 前記配線パターンのいずれかが電極用もしくは接地用のペタパターンに形成されていることを特徴とする請求項8、7または6記載の配線基板。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】 本発明は導体層付異方性導電シートおよびこれを用いた配線基板に関する。

【0002】

【従来の技術】 図19に示すように、表面に配線パターン1が形成された樹脂基板2を複数枚積層して形成した多層のプリント配線基板がある。

【0003】

2

【発明が解決しようとする課題】 上記多層のプリント配線基板によれば、配線パターン1の引回しの自由度が増大することから高密度の配線パターン1の形成が可能となる。しかしながら、各層の配線パターン1間の電気的接続は、スルーホール3を形成し、このスルーホール3に無電解めっき皮膜を形成して行うようにしているため、製造工程が長くコスト高になると共に、樹脂基板2を複数枚積層することから、厚さも大きくなるなどの問題点がある。そこで本発明は、上下の配線パターン間の電気的接続が簡単に容易に製造でき、また厚さも薄くできる配線基板およびこれを用いて好適な導体層付異方性導電シートを提供することを目的とする。

【0004】

【課題を解決するための手段】 本発明は上記目的を達成するため次の構成を備える。すなわち、本発明に係る導体層付異方性導電シートは、樹脂中に金属粉等の導電フィラーが配合された異方性導電シートの表面に導体層が形成されていることを特徴としている。この導体層付異方性導電シートは、配線基板、半導体装置用パッケージ等に広範に使用することができる。導体層は金属箔で形成することができる。

【0005】 また本発明に係る配線基板では、無面に配線パターンが形成された基板間に一方の面に配線パターンが形成された異方性導電シートの他方の面が固着され、該配線パターン間が前記異方性導電シートを介して電気的に接続されており、前記異方性導電シートに形成された配線パターンの外部接続部を露出して電気的絶縁皮膜が形成されていることを特徴としている。

【0006】 前記異方性導電シートに形成された配線パターンにより前記異方性導電シートを押圧することにより電気的に接続することができる。あるいは、前記基板に形成された配線パターンにバンパを形成し、このバンパにより前記異方性導電シートを押圧することにより電気的に接続することができる。このようにすれば、配線パターンをほぼ平坦に維持できる。

【0007】 さらに本発明に係る配線基板では、一方の面に配線パターンが形成された異方性導電シートが複数枚積層して固着され、かつ最下層の異方性導電シートの他方の面が表面に配線パターンが形成された基板面に固着され、前記配線パターン間が前記異方性導電シートを介して電気的に接続されており、最上層の異方性導電シートに形成された配線パターンの外部接続部を露出して電気的絶縁皮膜が形成されていることを特徴としている。

【0008】 この場合、前記異方性導電シートに形成された配線パターンにより前記異方性導電シートを押圧して電気的に接続することができる。あるいは、前記基板に形成された配線パターンおよび内層となる異方性導電シートに形成された配線パターンにバンパを形成し、このバンパにより前記異方性導電シートを押圧することにより

30

(3)

特開平8-330358

より電気的に接続することができる。このようにすれば、配線パターンをほぼ平坦に維持できる。  
 [0008] またこの場合、前記配線パターンのいずれかを導電用もしくは接地用のベタパターンに形成することができる。電線用のベタパターンとすると、電線ラインの引出しが容易となり、接地用ベタパターンとすると、いわゆるデカップリングコンデンサを形成でき、電気的特性を向上できる。

[0010]

【発明の実施の形態】以下、本発明の好適な実施の形態を添付図面に基づいて詳細に説明する。図1は本発明に係る添付する導体層付異方性導電シートを用いた半導体装置30の断面図を示す。32は半導体チップ、34はシリコン等からなるパッシベーション膜、36は半導体チップ32に作り込まれた電極であるAlパッド（パッド部）である。Alパッド36の部位にはパッシベーション膜34は形成されず、Alパッド36は露出している。Alパッド36は所定のパターンで半導体チップ32上に多数形成されている。38は異方性導電シートであり、パッシベーション膜34を覆って形成されている。異方性導電シート38は樹脂中に金属粉等の導電フィラー39（図2）が配合されており、加圧することによってこれら導電フィラー39が加圧方向に連続し、加圧方向に導電性が生じるものである。

[0011] 40は配線パターンであり、所定のパターンで異方性導電シート38上に形成されている。配線パターン40は図2に示すように異方性導電シート38に食い込むように加圧され、これにより該部位の異方性導電シート38が加圧され、該部位の異方性導電シート38が導通し、Alパッド36と配線パターン40とが電気的に接続される。配線パターン40は、銅等の金属箔を異方性導電シート38上に貼着し、この金属箔をエッチングして所定パターンに形成される。あるいはスパッタ等により銅またはアルミニウム等の金属層を形成し、エッチングしてパターンを形成してもよい。42は感光性レジスト膜（電気的絶縁皮膜）であり、異方性導電シート38および配線パターン40を覆って形成されている。感光性レジスト膜42は配線パターン40の保護膜であり、種々の材質の感光性ソルダーレジストを用いることができる。

[0012] 感光性レジスト膜42の各配線パターン40に対応する適宜部位には、例えば感光性レジスト膜42上にマトリクス状の配置となるように選孔44が形成されている（選孔44により露出する配線パターン40の部分が外部接続端子接合部40a）。46は外部接続端子であるバンプであり、各選孔44を通じて各外部接続端子接合部40aに電気的に接続して配置され、感光性レジスト膜42上に突出して外部接続端子に形成されている。バンプ46は図示のとくはんだボール等のボールバンプに形成することもできるが、平坦なランド

状その他の形状に形成できる。あるいはリードピンを接続して外部接続端子としてもよい。またバンプはニッケル/金めっき等のめっきにより形成してもよい。48は保護膜であり、半導体チップ32、パッシベーション膜34、異方性導電シート38の側壁を覆って形成され、各層の境界からの湿気の進入等を防止する。保護膜48は適当な材質の樹脂等のレジストを用いて形成できるが、必ずしも設けなくともよい。また、保護膜48に加えて、金属等からなる枠体を固着してもよい。

[0013] 上記のように形成されているので、半導体チップ32と同サイズの半導体装置30に形成できる。またインターポーザとなる異方性導電シート38および感光性レジスト膜42は薄く形成できるので、薄い半導体装置30に形成できる。異方性導電シート38および感光性レジスト膜42は硬度がそれほど高くないので、半導体チップ32表面を保護する緩衝層としても機能する。なお、半導体チップ32の反対側の面は露出させて放熱性を高めるようにすると好適である。さらに放熱性を向上させるために、ヒートシンクあるいはヒートスプレッダー（図示せず）を固着してもよい。

[0014] 図3は他の実施の形態を示す。本実施の形態では半導体チップ32のAlパッド36上に例えば図1よりバンプ37をパッシベーション膜34より高く突出するように設け、異方性導電シート38をパッシベーション膜34上に固定する際、突出するバンプ37により異方性導電シート38が加圧されて該部位の異方性導電シート38が導通してAlパッド36と配線パターン40とが電気的に接続するようになっている。本実施の形態の他の部位は図1に示す実施の形態と同じであるので図示を省略する。本実施の形態でも上記と同様の効果を奏する。さらに本実施の形態では、配線パターン40をほぼ平坦に形成できるので積層する場合に有利となる。

[0015] 図4、図5は図1に示す半導体装置30を製造する製造工程を示す。図4に示すように、異方性導電シート38上に銅箔等の金属箔を貼着し、この金属箔を全般的フォトリソグラフィ工程によりエッチング加工して配線パターン40を形成する。なお、スパッタ等により金属層を形成し、この金属層をエッチング加工して配線パターン40を形成してもよい。この配線パターン40を形成した異方性導電シート38を図5に示すように半導体チップ32のパッシベーション膜34上に配線パターン40が対応するAlパッド36と重なるように位置決めして配置する。次いで、Alパッド36の配線パターンにしたがって押圧突起41が形成された圧着治具43を用いて配線パターン40ならびに異方性導電シート38を押圧すると共に加熱して異方性導電シート38をパッシベーション膜34上に融着する。その際配線パターン40は押圧突起41に押圧されて図2に示す状態に変形し、この部位の異方性導電シート38が加圧され、Alパッド36に接触すると共に導通し、配線パター

(4)

特開平8-930356

5

ン40とA1パッド38が電気的に接続される。

【0016】次に電気的絶縁皮膜42を形成すべく、異方性導電シート38上および配線パターン40上に感光性レジスト（感光性ソルダーレジスト）を塗布し、露光、現像して透孔44を形成する。なお、電気的絶縁皮膜42は予め異方性導電シート38および配線パターン40上に形成し、しかる後異方性導電シート38を半導体チップ32上に固着してもよい。この透孔44内にはんだボール（バンプ46）を配置し、リフローしてはんだボールを配線パターン40上に固定する。上記のようにして半導体装置30に完成できる。なお、必要に応じて半導体装置30の側壁にレジストを塗布し、乾燥させて保護膜48を形成する。

【0017】上記実施の形態では個片にした半導体チップ32を用いたが、半導体チップ32が多数作り込まれたウェハーを用いてもよい。そして上記と同様にしてウェハー上に異方性導電シート38、配線パターン40、感光性レジスト膜42、バンプ46を作り込んで、スライスして個片に分離することにより、一時に多数の半導体装置30を形成することができ、コストの低減化が図れる。また、配線パターン40は異方性導電シート38を半導体チップ32に固着した後に形成してもよい。

【0018】次に図8に示す実施の形態の半導体装置30を製造する方法を示す。まず、半導体チップ32のA1パッド36上に金バンプ37をあらかじめ形成し、この金バンプ37の上に、図4に示す配線パターン40を形成した異方性導電シート38を重ね、熱圧着させればよい。この場合には図8に示すような押圧突起41を有する圧着治具43は用いる必要がない。すなわち、熱圧着する異方性導電シート38を全体的に押圧することで、金バンプ37が異方性導電シート38内に食い込み、これにより該部位の異方性導電シート38が加圧され、増強するからである。感光性レジスト膜42、バンプ46は前記実施の形態と同様に形成できる。なお、配線パターン40は異方性導電シート38を熱圧着した後に形成してもよい。また電気的絶縁皮膜42は予め異方性導電シート38および配線パターン40上に形成し、しかる後異方性導電シート38を半導体チップ32上に固着してもよい。

【0019】図9は半導体装置30のさらに他の実施の形態を示す。本実施の形態では複数の半導体チップ32をヒートスプレッド等の共通の基板47上に搭載し、複数の半導体チップ32上に、前記と同様にして共通の異方性導電シート38を形成し、該異方性導電シート38上に各半導体チップ32に対応する各配線パターン40と、隣接する半導体チップ32を電気的に接続するための所要の電極38同士間を接続する配線パターン45とを前記実施の形態と同様に形成し、その上に前記と同様に共通の電気的絶縁皮膜42を形成し、各配線パターン40の外部接続端子接合部40aにバンプ4

6

6を形成するようにしたものである。すなわち複数の半導体チップ32を用いた1つの半導体装置（マルチチップモジュール）30に形成したものである。複数の半導体チップ32としては、例えばMPUとキャッシュメモリ、複数のメモリ同士などを接続できる。本実施の形態では、複数の半導体チップを共通の基板47上に搭載し、電極間を配線パターンにより電気的に接続したので、配線を短くでき、信号の遅延防止等の電気的特性に優れた半導体装置を提供し得る。また異方性導電シートおよび電気的絶縁皮膜を共通にして形成することで製造も容易となる。なお、複数の半導体チップ32を共通の基板（図示せず）で保持するようにすれば基板47は必要ない。あるいは複数の半導体チップを共通のウェハー上に形成することもできる。本実施の形態の半導体装置30も上記と同様の工程で製造できる。

【0020】図7は半導体装置30のさらに他の実施の形態を示す。前記実施の形態と同一の部材は同一の符号を付している。本実施の形態では、半導体チップ32の上面に形成する異方性導電シート38を多層（本実施の形態では2層）に形成している。1層目の異方性導電シート38は図3に示す実施の形態と同様に半導体チップ32のA1パッド36上に金バンプ37により形成したバンプ37によって押圧することで、その配線パターン40とA1パッド38とを電気的に接続するようにしている。また2層目の異方性導電シート38も同様にして、1層目の配線パターン40の通所に形成したバンプ37によって押圧して、1層目と2層目の配線パターン40間の電気的導通をとるようにしている。42は感光性レジスト膜（電気的絶縁皮膜）であり、異方性導電シート38および配線パターン40を覆って形成されており、種々の材質の感光性ソルダーレジストを用いることができる。

【0021】感光性レジスト膜42の各配線パターン40に対応する適宜部位には、例えば感光性レジスト膜42上にマトリックス状の配置となるように透孔44が形成されている（透孔44により露出する配線パターン40の部分が外部接続端子接合部40a）。46は外部接続端子であるバンプであり、各透孔44を通じて各外部接続端子接合部40aに電気的に接続して配置され、感光性レジスト膜42上に突出して外部接続端子に形成されている。バンプ46は図示のとくばんだボール等のボールバンプに形成することもできるが、平坦なラウンド状その他の形状に形成できる。あるいはリードピンを接続して外部接続端子としてもよい。なお、本実施の形態においても、配線パターン40間および配線パターン40とA1パッド38との間の接続を図1に示すように配線パターン40を押圧して接続してもよい。

【0022】本実施の形態においても、半導体チップ32と同サイズの半導体装置30に形成できる。またインターポーザとなる異方性導電シート38および感光性レ

(5)

特開平8-330358

7

ジスト膜42は薄く形成できるので、薄い半導体装置30に形成できる。異方性導電シート38および感光性レジスト膜42は硬度がそれほど高くないので、半導体チップ32表面を保護する緩衝層としても機能する。なお、半導体チップ32の反対側の面は露出させて放熱性を高めるようにすると好適である。さらに放熱性を向上させるために、ヒートシンクあるいはヒートスプレッダー（図示せず）を固着してもよい。

【0023】図8は、上記異方性導電シート38を多層に設けた場合の他の実施の形態を示す。本実施の形態では、中間層となる配線パターン40のいずれかを電源用もしくは接地用のベタパターン40bに形成している。上層の配線パターン40と半導体チップ32のA1パッド36との接続は、図示のとおり、ベタパターン40bにリング状の通孔を設けてベタパターン40bと独立させたパターン40cに設けたバンブ37およびA1パッド38に形成したバンブ37を介して接続するようにすることができ、あるいはベタパターン40bに単に通孔を設けて、上層の配線パターン40を挿入して異方性導電シート38、38を介して接続するようにすることもできる。電源用あるいは接地用のA1パッドとベタパターン40bとの間の接続、ベタパターン40bと上層の配線パターン40の必要部との接続も上記と同様にしてバンブ37やあるいは配線パターン40、40bを挿入して行うことができる。上記ベタパターン40bを電源用のベタパターンとすると、上層の配線パターン40の電源ラインの引回し、あるいは電源用のA1パッドの配列が自由で容易となり、接地用ベタパターンとすると、引回しの自由度が向上するほか、ベタパターン上にスパッタリング等によりいわゆるデカップリングコンデンサを形成でき、電気的特性を向上できる。またスパッタリング等により、抵抗等の素子を作り込んでもよい。

【0024】図9、図10はさらに他の実施の形態を示す。41はポリイミド、エポキシ、ポリエステル等からなる絶縁性シートであり、その一方の面に銅箔等によって配線パターン40が形成されている。この配線パターン40の外部接続端子接合部40aとなる部位の絶縁性シート41には通孔44が形成されていて、該外部接続端子接合部40aは露出されている（図9）。38は前記と同様の金属粉等の導電フィラーが配合された異方性導電シートである。また37は半導体チップ32のA1パッド上に形成したバンブである。本実施の形態では、配線パターン40が形成された絶縁性シート41の一方の面を異方性導電シート38側に向けて、半導体チップ32、異方性導電シート38、絶縁性シート41を覆層し、加圧して一体化している。これによりバンブ37によって異方性導電シート38が挿入され、該部位の配線パターン40とA1パッドとが電気的に接続される。通孔44には外部接続端子となるバンブ48を形成して半導体装置30に完成される。なお、バンブ37は配線パ

8

ターン40側に形成してもよい。本実施の形態においてもチップサイズの半導体装置を容易に形成できる。配線パターン40とA1パッドとの間の接続も異方性導電シート38を介して容易に行える。図11は、配線パターン40を設けた絶縁性シート41を半導体チップ32上に多層に設けた実施の形態を示す。絶縁性シート41間の間隙は接着剤43によって行い、また配線パターン40、40間の電気的な接続はビア45によって接続している。最下層の絶縁性シート41は前記と同様にして異方性導電シート38を介して固定し、かつ電気的接続をとっている。本実施の形態でも、中間の配線パターンを電源用もしくは接地用のパターンに設けてもよい。

【0025】なお、上記各実施の形態では配線パターン40は銅箔等の金属箔により形成したが、異方性導電シート38をあらかじめ配線パターン40の形状にプレス等により押圧して、該押圧部位に導通性を持たせたものをそのまま用いるようにしてもよい。このようなことで工程の短縮ができコストの大幅の低減化が可能となる。本発明における配線パターンは異方性導電シートを加圧して形成した場合も含むものである。

【0026】図12は本発明に係る導体層付異方性導電シート50を示す。この導体層付異方性導電シート50は異方性導電シート52の表面に銅箔等の導体層54を形成したものである。異方性導電シート52は、エポキシ、ポリイミド、シリコン等の樹脂に金属粉等の導電フィラーを配合したものである。シリコン樹脂は、ゴム状弾性を有するので、特に半導体チップと実装基板との間に生じる応力を緩和できる。導電フィラーは、Ni、Ag、Ag-Pd等の金属粉、Ni、Ag、Ag-Pd等の金属箔を樹脂（エポキシ、ポリイミド、シリコン等）で被覆したもの、樹脂の被（エポキシ、ポリイミド、シリコン等）にNi、Ag、Ag-Pd等のめっき皮膜を形成したものなどを、シートを押圧することにより導電フィラーが露出して導電性が生じるに必要な量だけ樹脂中に配合される。導体層54は、異方性導電シート52に銅等の金属をスパッタリングしたり蒸着して形成することができる。あるいは、銅等の金属箔上に、樹脂に導電フィラーを配合してペースト状にした異方性導電材料をキャスティング（ドクターブレード法）してシート状にし、キュアして導体層付異方性導電シートに形成するようにすることができる。この導体層付異方性導電シート50は、図1～図11に示した半導体装置30を形成するのに好適に用いることができる他、以下に示すような配線基板に好適に用いることができる。

【0027】図13は配線基板56の一例を示す。58は表面に公知の手法により銅箔等によって配線パターン60を形成したプリント配線基板（基板）である。52は図12に示す導体層付異方性導電シート50の導体層54をエッチング加工して表面に配線パターン62が形

50

(6)

特開平6-330350

9

成された異方性導電シートである。この異方性導電シート52は配線パターン82が形成された面と反対側の面とプリント配線基板58上面に固着される。そして配線パターン82上から押圧具(図示せず)により配線パターン82の部位を押圧し、配線パターン82を変形させることにより、異方性導電シート52を介して配線パターン82と配線パターン80との間の電気的導通をとっている。

【0038】64は感光性レジスト膜(電気的絶縁皮膜)であり、異方性導電シート52および配線パターン82を覆って形成されている。感光性レジスト膜64は配線パターン82の保護膜であり、種々の材質の感光性ソルダーレジストを用いることができる。感光性レジスト膜64の各配線パターン82に対応する適宜部位には、透孔66が形成されている(透孔66により露出する配線パターン82の部分が外部接続部62a)。外部接続部62aにははんだ等により外部電子部品が接続可能となっている。

【0039】異方性導電シート52および感光性レジスト膜64は薄く形成できるので、薄い配線基板58に形成できる。特にシリコン樹脂を用いた場合、ゴム状弾性を有するので、プリント配線基板と実装される外部電子部品との間に発生する応力を緩和できる。異方性導電シート52および感光性レジスト膜64は硬度がそれほど高くないので、実装される外部電子部品を保護する緩衝層としても機能する。また上記のように、異方性導電シート52を用いているので、配線パターン80、82間の電気的接続は容易に行える。

【0040】図14は配線基板58の他の実施の形態を示す。図13に示す実施の形態と同一の部材は同一の符号を付し、その説明を省略する。本実施の形態では、図3に示すのと同様に、配線パターン80上に凹部によりバンブ81を形成し、このバンブ81により異方性導電シート52を押圧し、これにより配線パターン82、80間の電気的接続をとっている。このようにバンブ81を形成することによって、配線パターン82をほぼ平坦に維持できるので異方性導電シート52を覆層する場合に有利となる。

【0041】図15は異方性導電シート52をプリント配線基板58上に多層に設けた実施の形態を示す。下層と上層の異方性導電シート52の配線パターン82間の接続、配線パターン82と配線パターン80間の接続は、図13に示すのと同様に配線パターンを押圧変形させて異方性導電シートを介して接続してもよいし、図示のように配線パターン80および配線パターン82上に形成したバンブ81、81によって異方性導電シート52を押圧して接続するようにしてもよい。このように異方性導電シート52により容易に電気的接続をとって多層の配線基板58に形成することができる。また、この場合に、図8に示すのと同様の構造により、中間の配線

10

パターン82を電源用あるいは接地用のベタパターン(図示せず)に形成することができる。上記ベタパターンを電源用のベタパターンとすると、上層の配線パターン82の電源ラインの引出しが自由で容易となり、接地用ベタパターンとすると、引出しの自由度向上と共に、ベタパターン上にスパッタリング等によりいわゆるデカップリングコンデンサを形成でき、電気的特性を向上できる。これら電源用あるいは接地用のベタパターンは実装する電子部品に対応して部分的に設けてもよい。なお、配線基板としてはセラミック配線基板を用いてもよい。

【0042】図16は配線基板58のさらに他の実施の形態を示す。本実施の形態では、配線パターン付きの異方性導電シート52を多層(図示の例では3層)に形成している。この場合、1層目の異方性導電シートには、両面に導体層を形成した前記の導体層付異方性導電シート50の導体層をエッチングして両面に配線パターン82、82aを形成したものを用い、2層目および3層目の異方性導電シート52は上記と同様に片面に配線パターン82を形成したものを用いて積層し、熱圧着して配線基板58としている。

【0043】1層目の異方性導電シートの両配線パターン82、82a間は、配線パターン82aを押圧して変形させることにより異方性導電シート52を介して電気的に接続するようにしている。1層目、2層目、3層目の配線パターン82間の接続はバンブ81および異方性導電シート52を介して行うようにしている。42、42は感光性レジスト膜(電気的絶縁皮膜)であり、両表面の配線パターン82および82aを覆って形成され、一方の感光性レジスト膜42に形成した透孔にははんだボール等の外部接続端子48を形成し、他方の感光性レジスト膜42に形成した透孔には配線パターン82を露出させて電子部品等の接続部に形成している。なお、各配線パターン82はあらかじめ異方性導電シート52上に形成しておいてもよいし、導体層付異方性導電シートを1層積層する度に導体層をエッチング等して形成してもよい。

【0044】なお、図17に示すように、1層目にはポリイミドシート、エポキシシート、異方性導電性シート等から成る絶縁性フィルム52a上に配線パターン82を形成したものを用い、2層目以上は上記同様に片面に配線パターン82を形成した異方性導電シート52を用いて、積層、熱圧着するようにしてもよい。この場合1層目の絶縁性シート52aに直接透孔を形成して外部接続端子48を形成するようにすることもできる。また絶縁性フィルム52aが異方性導電シートであるときは表面を保護するためレジストを塗布してもよい。

【0045】また上記の各実施の形態において、外部接続端子たるバンブ48は、図18に示すように、外部接続端子接続部40a、および電気的絶縁皮膜42aあるい

50



12

86 透孔

【図12】極体層付異方性導電シートの断面図である。＊

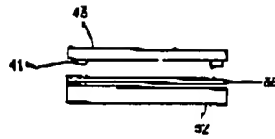
(8)

特許平 8-330358

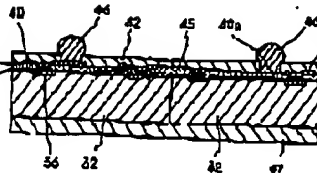
【図4】



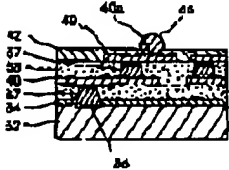
【図5】



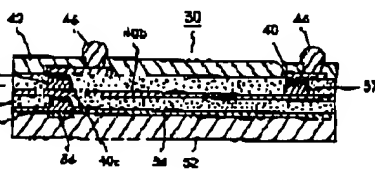
【図6】



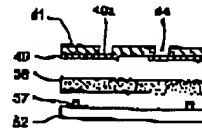
【図7】



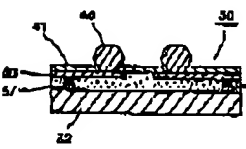
【図8】



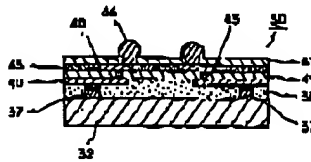
【図9】



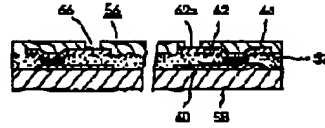
【図10】



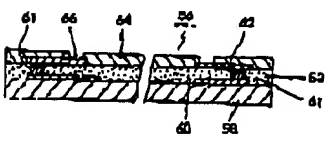
【図11】



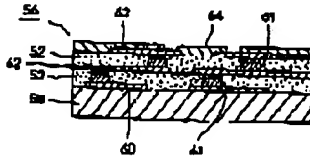
【図12】



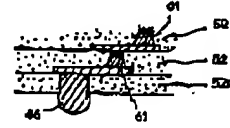
【図14】



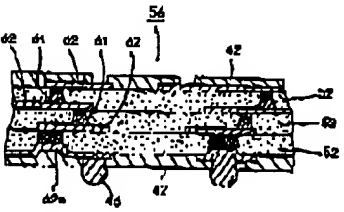
【図15】



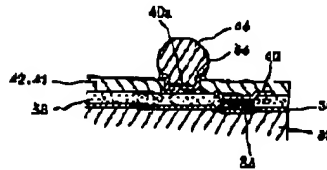
【図17】



【図16】



【図18】



(9)

特開平8-830358

【図19】

